# エレクトロニクス

## サーキットフォーメーション

### 表面前処理

**マイクロエッチング**

**各種エッチング剤**

| 系統 | プロセス名 | 特徴 | 用途 |
|---|---|---|---|
| 硫酸／<br>過酸化水素系 | Metex G-5 | 適度な凹凸<br>銅箔依存性が少ない | 各種前処理 |
| | Metex G-6 | 適度な凹凸<br>塩化物の影響が少ない | 各種前処理 |
| | ME-501 | 適度な凹凸<br>銅箔依存性が少ない<br>塩化物の影響が少ない | 各種前処理 |
| | ME-602 | 銅箔依存性が少ない<br>塩化物の影響が少ない<br>防錆効果 | ドライフィルム、<br>ソルダーレジスト用前処理 |
| | ME-605 | 大きな凹凸とマットな外観 | ドライフィルム、<br>ソルダーレジスト用前処理 |
| | ME-709 | 1液ﾀｲﾌﾟのｴｯﾁﾝｸﾞ剤<br>比較的平滑、塩化物の影響小さい | ハーフエッチ |
| 過硫酸塩系 | ﾏｲｸﾛｸﾘｰﾝ | 比較的大きな凹凸 | 各種前処理 |
| | ME-301 | 比較的大きな凹凸 | 各種前処理 |
| | PR-820 | 平滑なエッチング形状 | 最終表面処理前処理 |
| 塩化銅系 | MultiPrep 200 | 大きな凹凸とマットな外観<br>ﾚｼﾞｽﾄ樹脂との優れた密着性 | ドライフィルム、<br>ソルダーレジスト用前処理<br>ｽﾙｰﾎｰﾙ樹脂埋め用前処理 |

**銅・真鍮防錆、密着向上剤**

**M-667**

M-667はめっき処理や表面処理の最後に使用することで素地表面に優れた防錆皮膜を形成させることができます。更に、めっきレジスト印刷前やドライフィルム等のフォトレジストラミネート前処理として使用すれば銅表面とレジストとの密着特性を向上させることができます。